


Beschichtungsanlage CC800® ML

Artikel-Nr. 800-MLAS3

Die CC800® ML von CemeCon mit DC-Sputter-Technologie sind besonders flexibel und universell einsetzbar. Sie beschichtet einfach und schnell mit allen nitridischen, boridischen und kohlenstoffbasierten Schichtwerkstoffen. Sie ist die wirtschaftliche Anlage für mittlere Stückzahlen und häufige Chargen- und Schichtwerkstoffwechsel. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität hat sich die CC800® ML-Baureihe in der Forschung und Entwicklung bewährt. Die modulare, offene Bauweise ermöglicht es, die Anlage mit vielen Erweiterungen und Optionen wie Messgeräten auszustatten.

Experten kontaktieren

 +49 2405 44 70 122

 coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Beschichtungsraum, Ø x h (mm)	Ø400 x 400
Substrattisch, Ø x Ø Satelliten x Anzahl der Satelliten (mm/Stück)	Ø400 x Ø130 x 6
Kathoden (Stück/mm)	4 x 500 (DC)
Maximale Abmessungen des Substrats Ø x h	Ø400 x 800 mm
Kapazität Bohrer, Ø6mm x 60mm (Stück)	1800
Kapazität WSP, 12,7mm x 3,5mm (Stück)	4920
Beladung (kg)	250
Schichtrate µm/h	2 µm/h
Zykluszeit für 3 Øm HYPERLOX® * (h)	5
Elektrisch leitende Schichten	ja
Elektrisch nicht leitende Schichten	nein
Elektrisch nicht leitende Substrate	Nein
Leistungsaufnahme max. (kVA)	135
Aussenabmessung mm (b x l x h)	1,050 x 3,350 x 2,200
Prozessverfahren	Sputtern mit Booster-Technologie. Alle etablierten DC CemeCon Schichten sind möglich.
*	auf 10 mm Fräser, volle Beladung, 3-fach Rotation

Hier finden Sie alle Beschichtungsschritte im Überblick:

[Alles zur Vorbehandlung hier ansehen](#)

[Alles zur Beschichtung hier ansehen](#)

[Alles zur Nachbehandlung hier ansehen](#)